

보도시점 2025.11.4.(화) 09:00 배포 2025.11.4.(화) 08:30

지식재산처, 반도체 기업과 지식재산 경쟁력 강화를 위해 함께 뚝다

- 반도체 패키징 전문 기업 스테코(주) 방문하여 현장 소통 간담회 개최 -

지식재산처는 11. 4.(화) 15시 TAB 공정* 기반의 첨단 반도체 제품을 주력으로 하는 반도체 패키징 전문 기업인 스테코(주)(충남 천안 소재)를 방문해 반도체 분야 지식재산 경쟁력 강화를 위한 간담회를 개최한다고 밝혔다.

* TAB(Tape Automated Bonding) 공정 : 유연한 필름 형태의 테이프 기판에 칩(Chip)을 직접 본딩하는 고밀도 반도체 패키징 기술

간담회는 최신 기술개발 동향과 지식재산 관련 애로사항을 청취하고, 반도체 지식재산 지원 정책을 소개하는 등 지식자산을 통한 반도체 산업 경쟁력 강화를 뒷받침하기 위해 마련됐다.

동 간담회에서는 고대역폭 메모리(HBM**)에 사용되는 칩(Chip) 적용 기술에 대한 특허 동향을 공유하여 반도체 기업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 할 예정이다.

** HBM(High Bandwidth Memory) : 다수의 메모리 칩(Chip)을 실리콘 관통전극을 이용해 수직 적층하여 데이터 저장 및 전송 능력을 높인 고대역폭 반도체 메모리

지식재산처는 지난 2월 반도체 분야 기업, 협회, 연구기관, 변리사 등으로 구성된 「반도체 지식재산협의체」를 출범시켰고, 4월에는 지식자산을 활용한 반도체 산업을 지속적으로 발전시키기 위한 방안을 모색하는 「반도체 특허 컨퍼런스」를 개최하는 등 반도체 분야 지식재산 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있다.

지식재산처 김희태 반도체심사추진단장은 “인공지능(AI), 자율주행 등 빠르게 변화하는 기술 경쟁 시대에 반도체 시장이 새로운 성장의 기회를 맞고 있다”면서, “지식재산처는 우리 반도체 기업들의 핵심기술이 사업화까지 연결되고, 진정한 성장을 이룰 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

※ 붙임 : 지식재산처 - 스테코(주) 간담회 계획 / 사진은 간담회 후 배포 예정

담당부서	반도체심사추진단 반도체심사조직공정심사팀	책임자	과 장	임현석 (042-481-5079)
		담당자	사무관	정구원 (042-481-8135)

□ 개 요

○ 일시 : '25. 11. 4.(화) 15:00~16:30

○ 장소 : 스테코(주)* (충남 천안시 서북구 3공단 1로 20)

* 삼성과 일본 Toray의 제휴로 설립된 디스플레이 구동 반도체 패키징 전문 업체

○ 참석자

- (지식재산처) 김희태 반도체심사추진단장, 임현석 반도체조립공정
심사팀장, 정구원, 임종형, 박중현 심사관 등 5명

- (스테코) 최기환 CEO, 김구영 연구소장, 한준수 PKG기술팀장, 이상훈
TEST기술팀장, 조형진 부서장, 사공병우 특허 담당, 김형국
교육 담당, 이다연 교육 담당 등 8명

□ 일 정

시 간	일 정	담 당
15:00~15:05 (5분)	인사 말씀	스테코(주) 최기환 CEO
15:05~15:10 (5분)	인사 말씀	지식재산처 김희태 단장
15:10~15:20 (10분)	스테코(주) 소개	스테코(주) 이다연 교육 담당
15:20~15:30 (10분)	지식재산처 반도체 산업 지원 정책 발표	지식재산처 정구원 심사관
15:30~15:45 (15분)	고대역폭 메모리(HBM) 칩(Chip) 적용 기술 및 특허 동향 발표	지식재산처 박중현 심사관
15:45~16:30 (45분)	지식재산 관련 애로사항 청취 및 상담	